

“芯动力”人才计划第三届集成电路产业

紧缺人才创新发展高级研修班暨产业促进交流会

由工业和信息化部人才交流中心、南京浦口经济开发区管理委员会主办的“芯动力”人才计划——第三届集成电路产业紧缺人才创新发展高级研修班暨产业促进交流会将于**2018年12月18日-19日**在南京举办！

本次研修班以“**芯人才、芯产业、芯交流**”为主题，将深入探讨自主培养高质量行业人才、增强集聚创新能力的人才储备，旨在通过以人才为核心的产业主力军建设，推动以技术为核心的产业发展，融入全球集成电路产业生态体系。同时，也为集成电路产业链各个环节的企业、协会、投融资机构、创业团队等搭建一个技术、应用、投资等领域内互换信息、探讨交流的平台。

主办单位

工业和信息化部人才交流中心
南京浦口经济开发区管理委员会

承办单位

IC智慧谷

支持单位

SEMI China | 氢联 | 新思科技 | 安徽畅感网络科技有限公司 | 深圳市贝思科尔软件技术有限公司 | 科大讯飞股份有限公司

协办单位

中国国际人才交流基金会 | 上海微技术工业研究院 | 中国电科大学 | 江苏省半导体行业协会 | 上海集成电路技术与产业促进

中心|南京市集成电路行业协会|南京集成电路产业服务中心|无锡市半导体行业协会|中国传感器与物联网产业联盟|科通芯城&硬蛋|集邦咨询|MEMS 咨询|第一创客|南京大数据产业协会|中国光学工程学会|微友助手|东南大学电子科学与工程学院|华东光电集成器件研究所|北京久好电子科技有限公司|艾新教育学院&茄子烩

支持媒体

EETOP|与非网|集微网|全球半导体观察|镁客网|电子创新网|科技日报|半导体行业观察|芯师爷|芯榜|半导体行业联盟|中国半导体论坛|人工智能头条|矽说|半导体圈|芯司机|芯智讯|芯通社|芯世相|光纤在线|讯石光通讯|IC 咖啡|EEPW

大会整体日程

日期	时间	活动安排
12月17日	下午	报到
12月18日	全天	大会主会场
	下午	分会场一：IC设计与制造技术研讨会 分会场二：集成电路从业机构交流会
12月19日	全天	分会场三：集成电路产业生态研讨会暨投融资合作专场交流会
	上午	分会场四：传感器技术在新兴领域的应用与发展研讨会 分会场五：半导体产业上下游对接会
	下午	考察学习 路线：南京涵月楼酒店大门-->浦口经济开发区展厅中心-->博郡新能源汽车-->欣铨科技-->车览台积电-->矽邦半导体封测服务平台-->越博动力系统-->南京涵月楼酒店门口

大会主会场日程安排（12月18日）

会议安排

- 1.主题：以人为本，芯动未来
- 2.形式：主题演讲+圆桌论坛
- 3.议程（根据实际情况动态调整）

	时间	演讲嘉宾	主题
上午	09:00-09:20	开班致辞	
	主题演讲		
	09:20-09:45	在 AI-IoT 时代的高科技人才培养	季明华 芯恩(青岛)集成电路资深研发副总、 前中芯国际资深副总裁
	09:45-10:10	超越摩尔领域的模式创新及人才建议	丁辉文 上海微技术工业研究院总经理
	10:10-10:35	面向 AI 的新 IC 人才培养	沈 莉 新思科技中国副总经理
	10:35-11:00	高端模拟 IC 设计人才培养	黄勍隆 深圳能芯半导体有限公司董事长、 前意法半导体公司(ST) 亚太区副总裁
	11:00-11:25	在体系结构黄金时代看人才发展趋势	陆佳华 美国赛灵思公司教育与创新生态总监
	11:25-11:50	浦口经济开发区产业政策宣讲	
	圆桌论坛		
	11:50-12:30	圆桌议题 (From Industry View) : 紧缺“芯人才” ; 人才发展突破 ; 政府引导 ; 产学研推动 发起人 : 季明华 本场嘉宾 : 沈 莉 黄勍隆 特邀嘉宾 : 孙立涛 东南大学电子科学与工程学院、 微电子学院(国家示范性微电子学院)院长 倪小龙 中国传感器与物联网产业联盟常务副秘书长	
中午	12:30-14:00	午餐	
下午	主题演讲		
	14:00-14:25	待定	郑 杰 中国国际人才交流基金会副主任
	14:25-14:50	集成电路产业人才发展 (拟)	周玉梅 中国科学院微电子研究所副所长
	14:50-15:15	无处不在的集成电路与人才需求	王志华 清华大学教授、IEEE Fellow
	15:15-15:40	从“芯”出发 , 打造中国集成电路人才培养教育生态	陈 炜 Arm 亚太大学计划高级经理
	15:40-16:05	新形势下中国集成电路产业现状与人才发展建议	谢志峰 艾新教育学院院长、芯片科普第一人
	圆桌论坛		
	16:05-17:00	圆桌议题 (From Academic View) : 产业人才缺口 ; 培养机制 ; 产业中主导角色 ; 引进、留住、扩大 发起人 : 谢志峰 本场嘉宾 : 郑 杰 周玉梅 王志华 陈 炜	

	抽奖
--	-----------

IC 设计与制造技术研讨会

(12 月 18 日下午)

IC 产业是国家的战略产业 ,IC 设计与芯片制造的整合和链接是整个产业的重要推动力 , 也是打造战略性新兴产业价值链的核心要素。本次技术研讨会旨在聚集 IC 设计与制造的专业人士 , 展望中国 IC 产业的发展未来。

会议安排

- 1.主题：IC 设计与制造
- 2.形式：主题演讲
- 3.议程（根据实际情况动态调整）

时间	内容	演讲嘉宾
14:00-14:30	集成电路产业以创新战略强化核心竞争力	季明华 芯恩(青岛)集成电路资深研发副总、 前中芯国际资深副总裁
14:30-15:00	华虹宏力嵌入式闪存工艺平台介绍	李冰寒 上海华虹宏力半导体制造有限公司 技术研发部副部长
15:00-15:30	后摩尔时代的微纳三维集成技术	朱 健 中国电子科技集团 55 所 首席科学家
15:30-16:00	打造封测产业技术创新链，助推企业技术创新发展	曹立强 江苏省半导体封装技术研究所所长 华进半导体封装先导技术研发总经理
16:00-16:30	半导体主流工艺制程技术的挑战和机会	卢平强 Silterra 高级市场总监 原台积电市场经理
16:30-17:00	什么才是“靠谱”的 ASIC 设计	杨 浩 Global Foundry - Avera Semi 大中华区设计总监

传感器技术在新兴领域的应用与发展研讨会

(12月19日上午)

本次研讨会拟邀请来自传感器行业的产学研各界专家齐聚，针对传感器在新兴领域的应用发表主题演讲，邀请工业、农业、建筑、医疗领域传感器应用端代表共话传感器产业的发展现状与未来趋势，面临的机遇与挑战。

会议安排

1.主题：传递“芯”技术，感知“芯”未来

2.形式：主题演讲+圆桌论坛

3.议程（根据实际情况动态调整）

时间	主题	嘉宾
8:30-9:00	签到	
主题演讲		
9:00-9:25	智能传感器构筑新兴领域发展基石	杨巍 中国电子科学研究院、中国电科发展战略研究中心高级工程师
9:25-9:50	传感器新应用的开发与挑战	陈智维 中芯芯片科技(南京)股份有限公司应用工程/MCU 副总
9:50-10:15	将传感器融合到物联网边缘智能器件设计中	陈昇祐 Mentor , A Siemens Business IC 设计方案事业部全球晶圆厂负责人
10:15-10:40	待定	缪建民 新加坡南洋理工大学 MEMS 中心创始人、华景传感创始人
10:40-11:05	集成传感器产业机遇与创新	刘泽文 清华大学微电子研究所教授、博士生导师
圆桌论坛		
11:05-12:00	传感器在工业、农业、建筑、医疗领域的应用	发起人 朱佳琪 国家智能传感器创新中心副总裁

集成电路从业机构交流会

(12月18日下午)

本次交流会将邀请集成电路相关领域协会、产业联盟、媒体、企业、高校、科研院所等机构人员，搭建一个展示业务规划、探讨品牌形象提升、思考人才吸引、助推产业发展的平台，促进从业机构信息共享、业务交流、合作共赢。

会议安排

- 1.主题：**展示芯形象，驱动芯人才，赋能芯产业。
- 2.形式：**圆桌会议（半开放）
- 3.议程（根据实际情况动态调整）**

时间	具体内容	机构/嘉宾
13:30-14:00	签到	
14:00-14:10	开场主持	
14:10-15:40	媒体代表围绕传递行业信息，助力机构、企业打造品牌形象等话题发言	电子创新网、EETOP、与非网、镁客网、半导体行业观察、中国半导体论坛、芯师爷、芯榜、微友助手等
	协会/产业联盟代表介绍业务范围，围绕提升机构知名度，加强合作，助力行业发展发言	南京大数据产业协会、南京集成电路产业服务中心、中国（南京）软件谷集成电路公共技术服务平台等
	企业/高校代表围绕树立品牌形象，吸引、培养人才发言	苏州云芯微电子、艾新&茄子烩、SGS通标标准技术服务有限公司、南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京邮电大学等
15:40-16:10	交流互动	
16:10-16:30	芯动力合作机构——芯动联盟授牌仪式	

半导体产业上下游对接会

(12 月 19 日上午)

本次对接会将聚合半导体产业链上下游合作伙伴，从产业信息交换，先进产品、技术推介等多方位推进半导体领域技术交流和产业对接，促进企业抱团发展，抓机遇、迎挑战，把握产业动向，助燃芯动力。本次活动拟开放 100 个免费参会嘉宾席位，欢迎半导体产业链及上下游企业领军人物、优秀代表报名参加，先到先得。

会议安排

- 1.主题：**半导体产业上下游对接暨半导体行业先进产品技术推介
- 2.议程**（根据实际情况动态调整）

时间	主题	演讲嘉宾
8:30-9:00	来宾签到	
9:10-11:30	打造 AI 芯片设计 IP 共享平台	王宪航 科通芯城&硬蛋 副总裁
	发言 & 合作需求对接 (拟)	秦继伟 新思科技 区域主管客户经理
	IPGoal 与中小 IC 设计企业的共荣之道	邹铮贤 四川和芯微电子股份有限公司 董事长
	汉旗科技发展之路 & 合作需求对接	刘本强 山东汉旗科技有限公司 总经理
	面向 SiP 模块的高精度微组设备 & 合作需求对接	王敕 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 董事长
	OFDR 技术及其在光通信领域的应用	李艳 东隆科技集团 高级产品工程师
	无线充电的应用与商机 & 合作需求	林崇仁 江苏元勋电子科技有限公司 研发总监
	发言&合作需求对接 (拟)	曹幻实 艾新教育学院 副院长
	睿创 P01" 智能显控在行业领域的产品结合案例推荐 & 合作需求对接	何齐庄 上海璇庄计算机系统工程有 限公司 董事长
	单位自主研发工规级 40 存储主芯片 EMMC 5.1 & 合作需求对接	魏智汎 江苏华存电子科技有限公司 主控设计事业部总经理
	国内首颗 38nm 工规级单核 2Gb SPI NAND 存储产品及应用方案	张晓华 东芯半导体有限公司 副总经理
发言 & 合作需求对接 (拟)	陆德善 中芯芯片科技 (南京) 股份有限公司 传感器事业部总经理	
11:30-12:00	合作洽谈&互动交流	

集成电路产业生态研讨会暨投融资合作专场交流会

(12月19日)

为促进集成电路行业产学研政界的沟通与交流,打造产业园区、孵化器、投融资机构与创新、创业型企业之间的合作对接平台。会议拟邀请相关单位负责人共话产业发展现状与未来投资热点,交流相关经验,同时为相关优质项目的发展壮大建言献策。本次活动拟开放8个路演席位及100个嘉宾席位;欢迎政府相关部门、集成电路相关行业协会及产业联盟、投资机构、行业创业者及拟创业者报名参加。

会议安排

1.主题:集成电路产业生态环境及投融资合作交流

2.议程(根据实际情况动态调整)

(1)产业环境及行业投融资趋势研讨会(12月19日上午)

时间	内容	演讲嘉宾
9:00-9:30	(拟)集成电路产业政策介绍及产业园区介绍分享	曹卫华 南京浦口经济开发区管理委员会主任
9:30-10:00	当前中国集成电路产业投资环境及未来产业投资需求	李亚军 上海临芯投资管理有限公司 创始人兼 CEO
10:00-10:30	小投资与大趋势	汤治华 和利资本投资合伙人
10:30-11:00	人工智能时代的创客觉醒	马宁 第一创客 CEO
11:00-11:30	光芯片:进展与投资机会	苏辉 中科光芯董事长
11:30-12:00	(拟)行业投资经验分享	孙治培 上海赛领投资管理有限公司

(2) 项目交流专场 (12月19日下午)

时间	内容	演讲嘉宾
13:30 -14:00	寒冬来临的挑战与机遇	王汇联 厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理
14:00 -14:30	浦口区人才及产业政策推介	(拟) 南京浦口经济开发区管理委员会
14:30-14:45	项目路演+Q&A 环节	郭正标 世域天基 CEO
14:45-15:00	项目路演+Q&A 环节	张德才 上海财盈电子 CEO
15:00-15:15	项目路演+Q&A 环节	Yoan Dupret 法国 Menta 董事总经理兼商务发展副总经理
15:15-15:30	项目路演+Q&A 环节	潘藩 苏州云芯微电子科技有限公司副总
15:30-15:45	项目路演+Q&A 环节	胡玉屏 江苏元勋电子科技有限公司总经理
15:45-16:00	项目路演+Q&A 环节	白冰 光子算术(北京)科技有限公司
16:00-16:15	项目路演+Q&A 环节	靳宗明 北京勇芯科技有限公司
16:15-16:30	项目路演+Q&A 环节	
16:30-17:00	自由对接及交流环节	